

DB-8202 型多功能粘片机

DB-8202 型多功能粘片机主要应用于垂直支架 LED、CHIP LED、单色显示模块、点阵式显示屏、PCB 等多种器件的管芯粘接到引线框架上的一种设备。

主要技术特点：

- 晶片台结构：采用双层直线导轨工作台和滚珠丝杠结构,具有很高的定位精度和重复精度。
- 点胶机构：采用摆臂式机械结构用于银胶取量控制，点胶头容易更换，应用于不同尺寸的晶片。
- 顶针机构： 偏心轮机构使顶针运行更平稳，柔和，具备快速换针能力。
- 焊臂机构：独特的四连杆机构确保粘接精度，粘接压力在 40-200g 之间可调。
- 框架工作台机构：采用双层直线导轨工作台和滚珠丝杠结构,具有很高的定位精度和重复精度。料盒由肘夹夹紧，粘片完成后方便更换,可放置多种不同框架的料盒。
- 图像识别系统：双 CCD 机构可进行芯片识别对准和芯片粘接对准。

主要技术指标：

- 粘片速度：450ms (包括 PRS 识别时间，物料间距小于 2mm)
- 粘片精度： $\pm 50 \mu\text{m}$ (XY 定位)
 $\pm 3^\circ$ (θ 向)
- 芯片尺寸：0.18×0.18 ~ 1.0×1.0mm
- 拾取机构
吸头：表面拾取型
旋转臂：轻型 90° 旋转
粘接压力：40-200g 可调
- XY 晶片台
有效行程：152mm×152mm (6" × 6")
重复精度： $\pm 0.005\text{mm}$
- 顶针 Z 向行程：2 mm (max.)
- 点胶机构
结构型式：45° 旋转臂(点胶位置可微调)
Z 向行程：10mm (max.)
- 框架工作台
行程范围：440mm×150mm
重复精度： $\pm 0.005\text{mm}$ (X、Y 向)

